2019年
年度报告摘要

公司代码:688396 公司简称:华润微

华润微电子有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节"经营情况讨论与分析"。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税),预计派发现金红利总额为 40,125,531.44 元(含税),占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过, 尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司,公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般 A 股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴国屹	卢书锦
办公地址	江苏省无锡市梁溪路 14 号	江苏省无锡市梁溪路 14 号
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域,为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控,在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力, 形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。公司制造与服务业务主要提供半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。此外,公司还提供掩模制造服务。

(二)主要经营模式

公司产品与方案板块业务目前主要采用 IDM 经营模式, 同时制造与服务板块业务向国内外半导体企业提供专业化服务。

公司产品及方案板块采用 IDM 经营模式, 主要原因为功率半导体等产品更加需要设计研发与制造工艺及封装工艺紧密结合,IDM 经营模式能够更好整合内部资源优势,更有利于积淀技术及形成产品群。

1、产品与方案业务板块

(1)研发模式

针对产品与方案板块的开发,公司制定流程控制文件《新产品开发控制程序》。研发流程主要包括立项、设计、样品试制及评价、试生产和量产五个阶段,每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。

(2)采购和生产模式

产品与方案板块依托公司全产业链制造资源,主要采取 IDM 经营模式经营,同时根据实际需要, 对少量阶段性产能或工艺不匹配的生产环节选择进行外协加工生产。

IDM 模式下,市场部门根据市场及客户需求制订销售计划,综合计划部根据销售计划制定生产计划,晶圆生产由公司制造中心完成,制造中心会根据内外部整体需求进行原材料采购计划。晶圆生产完成后通过公司封测平台进行封装测试。如有需要外协加工的情况,公司在严格遴选委外供应商的基础上,严格管理和跟踪外协加工全过程,保证产品的质量和性能要求,同时高度重视核心技术的保密工作。

(3)销售模式

公司产品与方案板块采取直销与经销相结合的模式,公司制定了《营销业务管理规定》《经销商通用规则》《市场部订单管理规定》等制度,具体规定和流程如下:

①接受订单与计划:市场部门将客户订单录入系统,包括产品规格型号、订购数量、价格、交货日期等,市场部门与运营中心根据库存情况确认可达成的交期,确认后对客户进行回复。市场部门根据客户提供的计划,提交运营中心,由运营中心按照需求组织制造生产。

②发货:对于款到发货的客户,公司确认收到客户的付款单后进行发货;对于授信客户,在授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

③开具发票:发货后,系统根据发货单自动生成销售发票,市场部门审核后将发票发送客户。

④对账及收款:公司会每月与客户进行对账确认,对于授信客户,市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况,以保证按期收款。

公司产品的终端客户数量众多, 部分销售需要通过经销商提供销售渠道以及日常的客户维护工作。公司选定的经销商具有丰富的销售网络及深厚的客户积累,是公司客户的重要组成部分。公司对经销商管理建立并执行全套的严格管理措施,经销商需提供终端客户资料,签订《经销商通用规则》《销售协议书》,再进行送样、报价、接单交易,公司会不定期对经销商进行实地拜访和核实。公司一般通过经销区域范围、客户资源、推广能力、技术支持、资金实力等方面综合考察经销商。公司主要经销商皆为行业内知名经销商,具有较强的营销管理能力,同时自身的技术水平和团队也能为终端客户提供一定的售前和售后技术支持服务, 从而有效地满足终端客户的需求。

2、制造与服务业务板块

(1)研发流程

公司制造与服务板块工艺技术研发遵循业界标准的研发流程, 具体包括立项评估、工程开发、产品验证、试生产、量产等重要环节,每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。

(2)采购模式

公司制造与服务板块主要采用"以产定采"的采购模式。晶圆制造服务主要采购原材料有硅片、化学品等;封装测试服务主要采购原材料有引线框、塑封料等。同时,公司采购部门会根据市场供应情况、价格变化情况及供应商交货周期等因素,结合生产计划对主要的原材料,进行适当的安全库存备货。

公司采购方式分为招标采购方式和非招标采购方式,公司经过多年发展,已和多数主要原材料供应商建立了良好的合作关系,建立了合格供应商名录,采购部门按采购计划在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。采购部门会根据采购类别和采购金额选择相应的采购方式,并与供应商签订相应的采购合同,内容包括采购金额、数量和供货日期等,货物经质检验收后入库。

(3)生产模式

公司具备完善的生产运营体系,采取"以销定产"的生产模式,由运营中心综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划。

对于晶圆制造业务,在接到客户的产品订单后,公司首先根据客户的需求确定客户产品所需的制程、规格并制定工艺路线和工艺流程等相关资料。综合计划部负责制造生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排,智能与信息化部负责提供生产自动化及生产系统方面的技术支持, 质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案, 订单通过评审后由制造部门负责落实生产。对于新客户或是新产品,制造中心与研发中心将协同公司相关部门进行立项评审,确定产品开发项目及相关的工艺路线、工艺流程,安排流片实验并完成相关的技术测试分析、封装测试分析、客户试用评估、可靠性考核评估等新品综合实验。通过客户验证评估后,公司对新产品进行试生产、小批量生产以评估产品的稳定性、一致性以及是否具备量产所需的工艺窗口。通过这些验证后,产品可以开始根据客户需求进入量产。公司质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测, 所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

对于封装测试业务,公司生产流程如下:客户有新产品封装测试需求,公司将先评估封测是否能承接并安排工程试验批,流程通过后进入量产阶段。客户提供封测代工需求计划,综合计划部依据产能情况评估计划承接量。公司在接到客户订单并收到客户圆片后,进行生产安排,并负责管理订单交期确认、生产计划安排、订单交付等事项。在具体的生产过程中,综合计划部负责封测生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排, 智能与信息化部负责提供生产自动化及生产支持系统方面等技术支持,质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案,订单通过评审后由制造中心负责落实生产,质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测,所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

晶圆制造业务及封装测试业务中,客户新产品需求在进入量产前的验证环节,依然采用签署合同或订单采购的方式进行,公司承担验证环节的生产成本,客户支付外协加工费用。

(4)销售模式

目前公司制造与服务板块以直销作为主要销售方式, 由市场部门负责销售管理,公司制造与服务板块主要客户是半导体企业,公司与国内众多半导体企业建立了稳定的合作关系,并与其在产品交期、质量控制、交货方式、付款方式等方面形成了标准化、系统化、合同化约束,客户一般会与公司签订框架性合同,根据具体的生产计划以订单方式向公司发出采购计划,公司生产完成后发货。发货后,系统根据发货单自动生成销售发票,市场部门审核后将发票发送客户。公司会每月与客户进行对账确认,对于授信客户,市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况,以保证按期收款。

公司采用 IDM 经营模式同时有助于形成以下重要竞争优势:作为拥有 IDM 经营能力的公司, 公司的产品设计与制造工艺的研发能够通过内部调配进行更加紧密高效的联系。受益于公司全产业链的经营能力, 相比 Fabless 模式经营的竞争对手,公司能够有更快的产品迭代速度和更强的产线配合能力。基于 IDM 经营模式,公司能更好发挥资源的内部整合优势,提高运营管理效率,能够缩短产品设计到量产所需时间,根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制,能更贴近市场与商业需求在产业链各个环节实现创新。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售,以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务,属于半导体行业。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于"制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业",行业代码"C39"。

半导体位于电子行业的中游,上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接,构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件,承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心, 是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一,影响着社会信息化进程。自 2000 年以来,我国政府颁布了一系列政策法规, 将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一, 大力支持集成电路行业的发展,如 2011 年国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014 年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》,2016 年国务院颁布的《"十三五"国家战略新兴产业发展规划》、2017 年工信部颁布的《物联网"十三五"规划》等。国务院 2019 年政府工作报告明确提出:"培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数字经济"。 随着 5G、物联网、人工智能、汽车电子、半导体照明、可穿戴设备等下游新兴应用领域的兴起,全球电子产品市场规模逐年扩大,带动了上游集成电路行业的加速发展。

近期,各市场研究公司 Gartner、IDC、IBS 等,对疫情之下的半导体市场作了最新预测,均将前期正向增长预测调整为下降趋势。疫情之下全球经济增长放缓会直接影响到终端需求端,终端需求的下降或会在三、四季度有所体现。物流受阻、跨国交流的受限将一定程度上影响国际贸易, 半导体是全球化的产业, 全球物流运输通畅、跨国间的深入交流对半导体行业至关重要。从终端应用来看,疫情之下,居家消费电子产品如智能设备、穿戴设备等销售提振,远程工作和在线访问需求的增加,数据中心建设和通信基础设施建设将加快, 这些将抵消一部分因智能手机和消费类电子下降的影响。同时,国内疫情缓解,工厂产能恢复,给国内厂商带来供应链重塑的机会, 国产替代有望进一步加速。根据海关统计,2019 年中国进口集成电路 4,451.3 亿块,同比增长 6.6%;进口金额 3,055.5 亿美元,同比下降 2.1%。出口集成电路 2,187 亿块,同比增长 0.7%;出口金额 1,015.8 亿美元,同比增长 20%。整体来看,半导体市场增长前景可观,我国集成电路自给率仍较低,依然有很大的成长空间。

功率半导体研发生产过程涉及量子力学、微电子、半导体物理、材料学等诸多学科,需要综合掌握外延、微细加工、封装等多领域技术工艺,并加以整合集成,属于技术密集型行业。功率半导体等电子产品对可靠性、稳定性、集成度等性能指标有较高的要求。一些比较复杂的系统,需要公司提供从芯片、应用电路到系统软件等全方位的技术支持。随着下游电子产品的升级换代,电子产品呈现多功能化、低能耗、体积轻薄的发展趋势,新产品、新应用的不断涌现,对功率半导体的制造封装工艺等方面提出了更高的技术要求,同时功率半导体差别化应用领域的快速拓展,光伏、智能电网、汽车电子、工业控制等跨领域的产品需求,对生产厂商专用半导体的配套设计能力也提出了更高的要求。因此, 本行业对新进入者有较高的技术壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业,产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。根据中国半导体协会统计的数据,以销售额计,公司在 2018 年中国本土半导体企业排名中位列第 10,是排名前 10 的企业中唯一一家 IDM 模式为主经营的企业。

根据中国半导体行业协会统计数据,以 2018 年度销售额计,公司是中国规模最大的功率器件企业。在功率半导体领域,公司多项产品的性能、工艺居于国内领先地位。其中,MOSFET 是公司最主要的产品之一,公司是国内营业收入最大、产品系列最全的 MOSFET 厂商。公司是目前国内少数能够提供 -100V 至 1500V 范围内低、中、高压全系列 MOSFET 产品的企业,也是目前国内拥有全部主流 MOSFET 器件结构研发和制造能力的主要企业,生产的器件包括沟槽栅 MOS、平面栅 VDMOS 及超结 MOS 等, 可以满足不同客户和不同应用场景的需要。根据 IHS Markit 的统计,以销售额计,公司在中国 MOSFET 市场中排名第三,仅次于英飞凌与安森美两家国际企业,是中国本土最大的 MOSFET 厂商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、第三代半导体材料带来发展新机遇

半导体行业经过近六十年的发展,目前已经发展形成了三代半导体材料,第一代半导体材料主要是指硅、锗元素等单质半导体材料;第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料,如砷化镓、锑化铟;第三代半导体材料是宽禁带半导体材料,其中最为重要的就是 SiC 和 GaN。和传统半导体材料相比,更宽的禁带宽度允许材料在更高的温度、更强的电压与更快的开关频率下运行。SiC 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点,使得其器件适用于高频高温的应用场景,相较于硅器件,可以显著降低开关损耗。因此,SiC 可以制造高耐压、大功率电力电子器件如 MOSFET、IGBT、SBD 等,用于智能电网、新能源汽车等行业。与硅元器件相比,GaN 具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高的电子迁移率的特点,是超高频器件的极佳选择,适用于 5G 通信、微波射频等领域的应用。未来,随着第三代半导体材料的成本因生产技术的不断提升而下降,其应用市场也将迎来爆发式增长,给半导体行业带来新的发展机遇。

2、新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

随着物联网、5G 通信、人工智能等新技术的不断成熟,消费电子、工业控制、汽车电子等半导体主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了半导体企业的规模增长。如在汽车电子领域,相比于传统汽车,新能源汽车需要用到更多传感器与制动集成电路, 新能源汽车单车半导体价值将达到传统汽车的两倍,同时功率半导体用量比例也从 20%提升到近 50%;在物联网领域,根据赛迪预测,预计未来三年,中国物联网市场规模仍将保持 20%以上的增长速度,到 2021 年,市场规模将达到 26,251.3 亿元。其中整体成本集中在 MCU、通信芯片和传感芯片三项,总共占比高达 60%-70%。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力,并且随着国内企业技术研发实力的不断增强,国内半导体行业将会出现发展的新契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	10,095,287,650.34	9,992,053,434.32	1.03	9,746,743,266.92
营业收入	5,742,784,130.70	6,270,796,546.92	-8.42	5,875,589,714.46
归属于上市公司股东的净利润	400,755,536.42	429,441,345.91	-6.68	70,282,921.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,311,510.92	322,189,448.00	-35.97	7,175,183.62
归属于上市公司股东的净资产	5,423,131,165.33	4,148,183,267.04	30.74	3,832,321,556.25
经营活动产生的现金流量净额	576,258,618.29	1,482,436,862.52	-61.13	1,667,456,151.22
基本每股收益(元/股)	0.4559	0.4886	-6.69	0.0800
稀释每股收益(元/股)	0.4559	0.4886	-6.69	0.0800
加权平均净资产收益率(%)	8.0281	10.6112	减少 2.5831 个百分点	2.5532
研发投入占营业收入的比例(%)	8.40	7.17	增加 1.23 个百分点	7.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,186,302,084.48	1,453,721,880.27	1,491,890,936.70	1,610,869,229.25
归属于上市公司股东的净利润	20,651,960.33	143,697,441.85	105,357,728.25	131,048,405.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,862,344.72	107,730,072.03	70,963,455.89	74,480,327.72
经营活动产生的现金流量净额	44,462,691.00	31,408,279.65	160,607,706.26	339,779,941.38

说明:公司第一季度由于受春节假期和年度生产线集中检修影响,销售收入占比较小、同时产能利用率的降低削弱了产品毛利。第二、第三与第四季度营业收入较为均衡且呈增长趋势,整体产品获利能力良好。由于计提存货跌价损失准备和期间费用的增加, 第三季度相对于第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润有所下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	1
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,449
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
华润集团(微电子)有限公司	0	878,982,146	100	878,982,146	878,982,146	无	0	国有法人

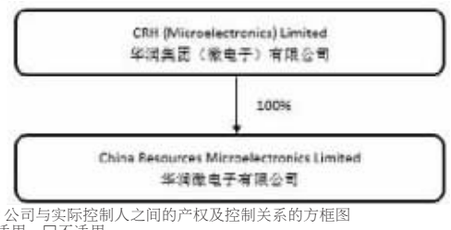
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

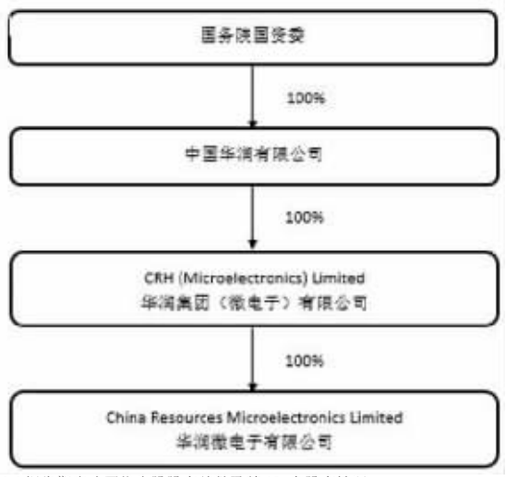
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域。2019 年度实现营业收入 57.43 亿,实现归属上市公司股东的净利润 4.01 亿元。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、经本公司管理层批准,自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将"应收票据及应收账款"拆分为应收账款与应收票据列示	2019 年 12 月 31 日应收票据列示金额 190,955,453.14 元,应收账款列示金额 815,007,869.96 元; 2018 年 12 月 31 日应收票据列示金额 506,851,449.81 元,应收账款列示金额 601,612,249.81 元。
将"应付票据及应付账款"拆分为应付账款与应付票据列示	2019 年 12 月 31 日应付票据列示金额 99,818,520.32 元, 应付账款列示金额 748,638,825.07 元; 2018 年 12 月 31 日应付票据列示金额 84,425,458.05 元,应付账款列示金额 715,574,795.52 元。
利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"	2019 年度资产减值损失列示金额-36,573,885.21 元; 2018 年度资产减值损失列示金额-71,737,556.14 元。

2、经本公司管理层批准,自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

3、经本公司管理层批准,自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)相关规定,企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

4、经本公司管理层批准,自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	报表科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
将原列报于"其他流动资产"理财产品、结构性存款重分类至"交易性金融资产"	其他流动资产 交易性金融资产	列示金额减少 507,535,344.46 列示金额增加 507,535,344.46	0
将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据从"应收票据"重分类至"应收款项融资"列示	应收票据 应收款项融资	列示金额减少 484,906,398.42 列示金额增加 484,906,398.42	0

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	注册地/主要生产经营地	持股比例(%)		主营业务
			直接	间接	
1	华润微电子控股有限公司	上海		100	发行人境内运营实体的主要持股公司
2	无锡华润上华科技有限公司	无锡		100	从事晶圆制造业务
3	无锡华润微电子有限公司	无锡		100	从事辅助运营管理职能并持有部分境内运营公司的股权
4	华润微电子(重庆)有限公司	重庆		52.69	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
5	无锡华润华晶微电子有限公司	无锡		99.662	从事分立器件产品及应用的研发、设计与销售
6	无锡华润安盛科技有限公司	无锡		100	从事公司半导体封装和成品测试业务
7	无锡华润矽科微电子有限公司	无锡		100	从事集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
8	华润赛美科微电子(深圳)有限公司	深圳		100	从事晶圆测试和成品测试业务
9	重庆润芯微电子有限公司	重庆		50.9	持有矽磐微电子股权
10	矽磐微电子(重庆)有限公司	重庆		48.72	从事集成电路封装业务
11	无锡迪思微电子有限公司	无锡		100	掩模板的加工制造及销售
12	华润矽威科技(上海)有限公司	上海		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
13	华润半导体(深圳)有限公司	深圳		100	集成电路产品和系统方案的设计、开发及销售
14	无锡华润芯功率半导体设计有限公司	无锡		100	分立器件销售
15	无锡华晶综合服务有限公司	无锡		100	负责发行人的仓储、食堂等后勤业务管理
16	润科投资管理(上海)有限公司	上海		51	投资管理、投资咨询
17	InPower Semiconductor Company Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
18	CSMC Asia Limited	中国香港	100		公司境外销售平台
19	CSMC Manufacturing Co., Ltd.	英属维京群岛	100		公司境外销售平台
20	China Resources Semiconductor International Limited	中国香港		100	公司境外销售平台
21	China Resources Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	持有发行人下属企业
22	Wuxi China Resources Microelectronics (Holdings) Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
23	CRC Microelectronics Company Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
24	Well-Known Property Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
25	Firstar Limited	英属维京群岛	100		持有发行人下属企业
26	Semico Microelectronics (BVI) Limited	英属维京群岛		100	持有发行人下属企业
27	Well -Known (Hong Kong) Property Limited	中国香港		100	无实际经营业务、持有物业
28	DIS Microelectronics (Hong Kong) Limited	中国香港		100	无实际经营业务
29	Bold Team Management Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
30	Advanced Microelectronics Limited	英属维京群岛	100		无实际经营业务
31	Qualibest Enterprises Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
32	Huajing Microelectronics Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
33	Logic Semiconductor Manufacturing Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
34	Micro Assembly Technologies Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务
35	Advanced Semiconductor Limited	英属维京群岛		100	无实际经营业务

(2)本报告期内合并财务报表范围变化

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比上期新增加 1 家、减少 2 家。

合并范围变更主体的具体信息详见"本节八合并范围的变更"。

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2020-016

华润微电子有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华润微电子有限公司(以下简称"华润微"或"公司")于 2020 年 4 月 21 日以现场及通讯(包括网络)相结合的方式召开了第一届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知于 2020 年 4 月 10 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实际到会董事 9 人,会议由公司董事长李福利先生主持,公司其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称"《章程》")、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李福利先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

议案内容:公司常务副董事长陈南翔先生代表公司经营管理层作 2019 年度总经理工作报告。2019 年度, 公司实现营业收入 574,278.41 万元, 较上年同期下降 8.42%;实现利润总额 50,595.28 万元,较上年同期下降 14.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 40,075.55 万元, 较上年同期下降 6.68%; 报告期末公司总资产 1,009,528.77 万元, 较期初增长 1.03%; 归属于上市公司股东的净资产 542,313.12 万元,较期初增长 30.74%。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于确定公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

议案内容:根据《章程》等公司相关制度,结合公司经营规模、2019 年度业绩结果等实际情况并参照行业薪酬水平, 同意公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过的公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,董事彭庆回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

议案内容:公司董事长李福利先生代表公司董事会作 2019 年度工作报告。2019 年度公司的股东大会、董事会和专门委员会运作规范,各位董事勤勉尽责,均能按照规定出席并对提交董事会审议的议案进行认真的审议和表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

议案内容:2019 年公司经营层在董事会的领导下基本完成了预定目标,经营情况良好。公司按照上海证券交易所的要求, 编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司 2019 年年度报告》及《华润微电子有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《2019 年度利润分配的议案》

议案内容:经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日, 公司期末可供分配利润为人民币 244,465,029.70 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税),预计派发现金红利 40,125,531.44(含税),占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.01%。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《2019 年度财务决算报告》

议案内容: 公司 2019 年度财务报表已经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《2020 年度财务预算报告》

议案内容:公司根据 2020 年度的经营目标和工作计划制定了 2020 年度财务预算报告。

特别提示:上述财务预算仅为公司 2020 年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

议案内容:公司于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司审计合规委员会提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容:公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司主要关联交易事项均按照市场原则定价,价格合理,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外,公司产供销系统独立、完整,生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司 2020 年度预计日常关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影